

平成27年7月13日

公募の通知

部品内蔵基板設計データフォーマット最終版 FUJIKO の開発公募要領

[1] 公募期間（期間厳守）

平成27年7月14日～平成27年7月27日（※最終日は17時まで）

[2] 開発内容

昨年度実施した JPCA 規格 JPCA-EB02（2013）に準拠して開発された部品内蔵基板設計データフォーマット FUJIKO の改良開発の更なる機能追加開発を行い、最終版 FUJIKO を開発する。

（1）開発の概要

昨年度開発した改良版 FUJIKO を踏まえて、更なる機能追加を実施し、最終版 FUJIKO を開発する。

福岡大学が定義する、基板の構造に関する基板定義データ及び内蔵する電子部品形状や特性に関する部品定義データについて、属性等の詳細設計を FUJIKO に反映するための機能追加を実施する。

（2）具体的内容

製造用情報として、表面および基板内に実装・内蔵する部品の情報を取り込む機能を追加する。

部品内蔵基板の製品設計、基板製造、部品実装、検査の各工程で機密を保持する為の、フォーマットの暗号化を設計する。

[3] 公募提出物等

(1) 提出物：① 会社概要、② 見積書、③ 開発内容に対する企画書

①、②は紙での提出。③はCD-R 又は DVD-R でのデータ提出。

様式はいずれも任意。ただし企画書には、基板定義データおよび部品定義データに付加すべき属性情報の提案、および当該データを FUJIKO に反映する際の追加機能の仕様について記述する事。

(2) 提出先：福岡大学半導体実装研究所

[4] 審査

審査委員会において審査の上、決定。

[5] 審査結果決定、発注先通知

平成27年7月31日

[6] 開発期間

平成27年8月1日～平成27年10月31日

[7] 納入締切・納入先

平成27年11月1日

納入先：福岡大学半導体実装研究所（福岡県糸島市東1963-4）

納品物：開発した最終版 FUJIKO フォーマット仕様書

[8] 検証（予定）

平成27年11月2日～平成27年11月15日

[9] 検収（予定）

平成27年11月16日

[10] 本件に関する問合せ先、見積等資料提出先、

福岡大学半導体実装研究所 加藤義尚宛

〒819-1122 福岡県糸島市東1963-4 三次元半導体研究センター内

TEL:092-332-9144 E-Mail:ykatoh@fukuoka-u.ac.jp

以上